

TEMI 電子元件拆鋸【專業級】課程暨能力認證

活動簡章

課程名稱：TEMI 電子元件拆鋸專業級課程暨能力認證

活動單位：台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會

課程日期：為2天活動，請參閱下表（課程1.5天 + 正式考試0.5天）

課程地點：TEMI 教育訓練中心(新北市中和區中山路二段419號6樓)

課程對象：**具通過電子元件拆鋸【實用級】能力認證**之全國高中職、大學學生、社會人士。

課程費用：**早鳥優惠價2,500元/位(須於2025/04/30前完成報名及匯款)**

一般優惠價3,500元/位(原價5,000元，含：講師費、助教費、講義費、訓練材料費、認證費、證書費，不含午餐)

活動梯次：

梯次	日期 2025	正取人數	教學內容	報名網址
US2572	5/17~18 (六~日)	15位	課程+認證	https://www.temi.org.tw/exam_batch_list/ 梯次編號：US2572(請勿報錯梯次)



課程內容：

日期 時間	第一天	第二天
09:00~09:20	始業式	●拆鐸成品板(SCBL)-檢測 (1) 鐸接實作 (2) 測試與檢修
09:20~10:00	●TEMI 能力認證 介紹 ●TIRT/TEMI 機器人國際賽介紹(技能類)	
10:00~12:00	●拆鐸成品板(SCBL) 拆鐸-拆卸 (1) 拆鐸成品板功能介紹 (2) 拆卸技巧說明 (3) 拆卸工具及零件識別 (4) 拆卸實作	
12:00~13:00	午餐時間	
13:00~16:00	●拆鐸成品板(SCBL)-功能測試 (1) 拆鐸測測試板說明 (2) 微控制器功能測試 ●拆鐸成品板(SCBL) 鐸接-回鐸 (1) 鐸接技巧說明 (2) 鐸接工具及零件識別 (3) 鐸接實作與功能測試	●電子元件拆與鐸認證 專業級認證 正式認證 (13:30~16:00)

※如有變動，請依當日課程為主※

活動報名：

1. 報名方式：請上 TEMI 網站報名 https://www.temi.org.tw/exam_batch_list/
2. 為確保每位參加同學皆能參與實作，每梯報名名額依規定人數為限，若報名人數未達總該梯報名人數 10 位，將公告合併於下一梯次/或取消辦理。
3. 報名期限：自培訓官網公告日期至活動前 7 天，或人數額滿為止。
4. 正取說明：依先報名並繳費完成的學員之優先順序，做為正取資格。
5. 繳交報名費後請將繳費收據<<註明梯次編號、學校、科系、姓名>>;以掃描電子檔 e-mail 至 aleeb@etimag.com.tw, 以確認報名順序。
6. 退費說明：請於報名的梯次截止日前 7 個工作天提出或於活動第一天因故未到但有提具證明文件者；將全額退費，酌收匯款手續費；其餘無故未到，或因故未在活動日期提出申請者，恕不退費。
7. 匯款資訊：
銀行：第一銀行-仁愛分行（代號 007-1602）
戶名：台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
帳號：160-10-082093

重要事項：

1. 煩請參與課程的學生於開課前，**務必要熟讀電子元件拆焊能力認證學科題庫**；
題庫下載：https://www.temi.org.tw/doc_download/
2. 凡通過電子元件拆焊實用級能力認證-學科成績達 80 分(含以上)，免考專業級學科。
3. 學科由於課程緊湊，請參與課程的學生務必全程參與課程、勿缺席；並準時到教室，遲到將無法跟上進度。
4. 學員參與認證，請務必攜帶具有大頭照之身份證件(如身份證或學生證)，做為考生身份核查之用。
5. 全程參與課程者，可獲得由 TEMI 協會頒發之培訓時數證書。
6. 通過認證考試者，可獲得 TEMI 協會能力認證證書(公協會/人力銀行背書)。



(培訓時數證書)



(能力認證證書)

競賽對接：

學員於培訓後，具參加 2025TIRT 機器人國際賽-積體電路應用系統-電子元件拆與焊專業級競賽資格。

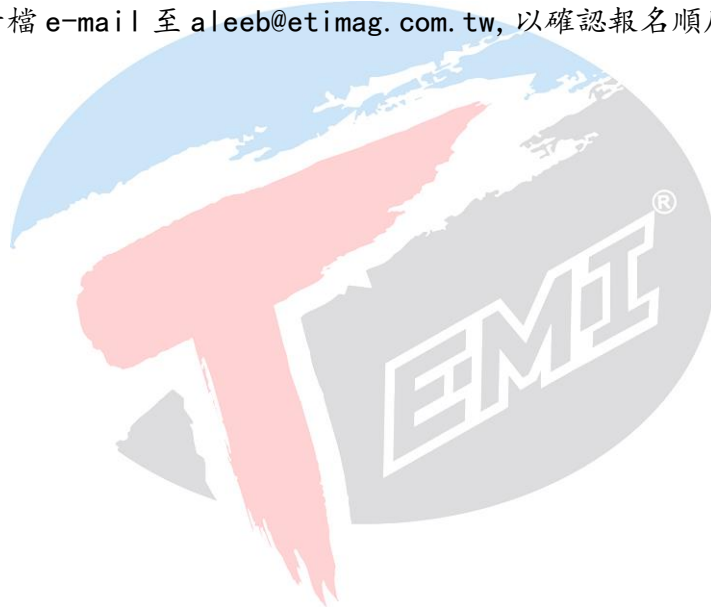
聯絡窗口：

單位	聯絡人	電話	電子郵件
台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會	李思萱專員	(02) 2223-9560#210	aleeb@etimag.com.tw

附件一、報名與匯款資訊

一、報名與匯款資訊：

1. 為確保每位參加同學皆能參與實作與競賽，每梯之每班報名名額以 15 人為限，若報名人數未達總該梯報名人數一半，將公告延期辦理。
2. 報名正取說明：依先報名並繳費完成的學員之優先順序，做為正取資格。
3. 報名期限：自培訓官網公告日期至活動前 7 天，或人數額滿為止。
4. 報名方式：請上 TEMI 網站報名 https://www.temi.org.tw/exam_batch_list/
5. 報名費繳費方式：
協會 TEMI（第一銀行）匯款帳號
銀行：第一銀行-仁愛分行（代號 007-1602）
戶名：台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
帳號：160-10-082093
6. 繳交報名費後請將繳費收據<<註明梯次編號、學校、科系、姓名>>
以掃描電子檔 e-mail 至 aleeb@etimag.com.tw, 以確認報名順序。



附件二、自備工具(必須自備工具實用級;建議規格,請學員必要帶,現場恕無提供)

項次	品名	規格(不限廠牌)	數量	參考圖示/說明 (建議)
1	三用電錶	1. 指針式/數位式均可 2. 1/2 數位電錶	1 台	 MT-1220
2	烙鐵	1. 陶瓷恆溫烙鐵 (AC110~120V) 2. 建議 30W 以上/消耗功率 60W 3. 溫度範圍 200~500° C	1 支	 SI-186A
3	烙鐵架	1. 單簧管烙鐵架 2. 建議插入式	1 支	 6S-2
4	熱風槍	1. 溫度保護 2. 多段溫控 300°C/500°C 及風速 3. 110V/1500W	1 台	 SS-611A  SS-969E
5	吸錫器	1. 雙環雙開吸錫器 2. 建議吸力達 32Hg-cm	1 支	 DP-366C-pic01
6	SMD 鑷子	1. 不銹鋼防磁彎尖鑷子 2. 建議(擇一亦可) 特尖鑷子: 全長 120mm 彎尖鑷子: 全長 120mm 鳥嘴尖鑷子: 全長 120mm	1 支	 1PK-104T
7	無酸焊油 助焊膏	1. 無酸焊油 (50g) 2. 建議無鉛環保無酸助焊錫膏	1 個	 8S005
8	錫絲	1. 免洗錫絲/高亮度錫筆 63% 2. 建議 0.8MM	1 個	 9S001
9	尖嘴鉗	1. 鉻釩鋼材質 2. 鉗長約 140mm	1 支	 8PK-906A
10	斜口鉗	1. 鉻釩鋼材質 2. 鉗長約 140mm 3. 刀口:HRC 62±3 本體:HRC 45±3	1 支	 8PK-905A
11	十字 螺絲起子	1. 十字型起子 2. PH1 或 PH2 3. 鉻鉬鋼彩條十字起子(#2 x100mm)	1 支	 89107B
12	一字 螺絲起子	1. 一字起子 2. PZ000 或 PZ0 3. 鉻鉬鋼彩條一字起子(3.2 x75mm)	1 支	 89101A
13	延長線	1. 使用電壓:AC 110V/60Hz 2. 額定電流:15A /額定容量:1650W 3. 輸出插座:AC 110V, 3 孔插座×4 4. 線長:1.8m	1 條	
14	檯燈	不限廠牌(視個人情況, 可省略)	1 支	
15	電池	1. 9 伏特 (9V) 2. 鹼性 / 充電式	4 個	

附件三、會員註冊、認證報名及繳費流程

一、會員註冊：

姓名及 mail 請勿隨意填寫，避免後台無法查詢 或 發 mail 通知



最新消息 ▾關於協會 ▾能力認證 ▾技藝技職教育 ▾培訓活動 ▾競賽活動 ▾人力平台 ▾下載專區 ▾會員專區 ▾

培訓活動報名

最新消息

影音專區

» 會員註冊

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點：TEMI教育訓練中心

活動日期：2024-08-31~2024-08-31

報名日期：報名截止

訊息公告

活動資訊

成果分享

競賽資訊

教師培訓

[2025-01-09] 報名現況

[2024-12-05] 德明技職力冬令營 - 積體電路應用知識力活動

[2024-11-14] 龍華2025TEMI技職力冬令營~電子元件拆錫實用級培訓暨認證



協會電子報

最新消息 ▾關於協會 ▾能力認證 ▾技藝技職教育 ▾培訓活動 ▾競賽活動 ▾人力平台 ▾下載專區 ▾會員專區 ▾

首頁 / 會員註冊

能力認證報名入口

線上註冊會員



培訓活動報名

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點：TEMI教育訓練中心

活動日期：2024-08-31~2024-08-31

報名日期：報名截止

» 更多活動查詢

聯絡資訊

台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會

信箱：temi@temi.org.tw

電話：(02)2223-9560#505

※姓名及 mail 請勿隨意填寫，避免後台無法查詢 或 發 mail 通知

姓名 *

Email(登入系統帳號) *

密碼 *

密碼確認 *

國籍 *

圖像認證 *


☒ 我已經閱讀 會員相關規定 隱私權政策

※記得勾選已閱讀

重寫資料

確認送出

二、請於完成註冊後，登入系統填寫基本資料

最新消息 ▾ 關於協會 ▾ 能力認證 ▾ 技藝技職教育 ▾ 培訓活動 ▾ 競賽活動 ▾ 人力平台 ▾ 下載專區 ▾ 會員專區 ▾

首頁 / 會員登入

能力認證報名入口

會員登入

請使用您的帳號登入

建議您使用 Google Chrome 瀏覽器 以利程序進行

請登入系統，並填完基本資料即完成會員註冊

能力認證 Certification

培訓活動報名

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點：TEMI教育訓練中心

活動日期：2024-08-31~2024-08-31

報名日期：報名截止

更多活動查詢

聯絡資訊

公證出入卡證會員系統管理協會

忘記密碼 申請帳號 登入系統

TEMI 會員專區

temi.org.tw/member_area/dashboard/home

台灣嵌入式單晶片... (一)TEMi線上教... TEMI 網站管理系統 競賽單位登入 - 管... 外交部領事事務局 - ... 三竹資訊備訊即時通 所有書籤

網站首頁 會員專區首頁

管理區首頁

會員資料管理

能力認證

培訓報名

文件下載

注意!!! 第一次登入請完成會員資料登錄 以便進行各項線上服務

英文姓名請務必填寫正確，並且仔細閱讀上傳照片的注意事項
上述資料有關證書印製，煩請務必填寫正確

三、認證梯次報名

TEMI 會員專區

temi.org.tw/member_area/member/edit_member_self/

台灣嵌入式電子產品... (一字)TEMI線上教... TEMI 網站管理系統 競賽單位登入 - 管... 外交部領事事務局 -...

TEMI 會員專區 Welcome 陳建宇

網站首頁 會員專區首頁 > 編輯會員基本資料

管理區首頁 會員資料管理 能力認證 能力認證報名紀錄 證照地圖 培訓報名 文件下載

編輯會員基本資料

會員基本資料(國籍：台灣)

* 中文姓名

* 英文姓名 PS.

* 性別 男 ☐ 女 ☐

生日

選擇欲報名的梯次

最新消息	關於協會	能力認證	技藝技職教育	培訓活動	競賽活動	人力平台	下載專區	會員專區
首頁 / 能力認證梯次表								
能力認證梯次表								
全部職類	全部級別	考試日期： ~ 搜尋						
梯次編號	職類	級別	考試地點	考試日期	梯次名稱	報名人數/上限	報名時間	線上報名
UK2505	電子元件拆與焊能力認證	知識力級	TKB甄戰學習顧問中心	2025-02-23	0223台南甄戰-拆焊知識力認證	0 / 10	2025-02-18 2025-02-19	報名
UP24555	電子元件拆與焊能力認證	費用級	龍華科技大學	2025-02-07	0207龍華-拆賣培訓認證專班(下午梯)	41 / 42	已結束	已結束
UK2401	電子元件拆與焊能力認證	知識力級	德明財經科技大學	2025-02-05	0205德明-電子創客知識力培訓暨認證	4 / 30	已結束	已結束
PK2401	電路板設計國際能力認證	知識力級	德明財經科技大學	2025-02-04	0204德明-電路板設計知識力培訓暨認證	7 / 30	已結束	已結束

如有“免試科目”請務必點選正確

最新消息	關於協會	能力認證	技藝技職教育	培訓活動	競賽活動	人力平台	下載專區	會員專區
------	------	------	--------	------	------	------	------	------

首頁 / 能力認證梯次一覽表 / 能力認證-線上報名

能力認證報名入口



培訓活動報名

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點：TEMI教育訓練中心
活動日期：2024-08-31~2024-08-31
報名日期：**報名截止**
» 更多活動查詢

聯絡資訊

台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
信箱：temi@temi.org.tw
電話：(02)2223-9560#505
(02)8227-5565
傳真：(02)8227-5559

能力認證 線上報名

報名基本資訊 認證說明 認證流程 考場一覽 考場 Gmap

梯次編號：UK2505 備註：

職類：電子元件拆與銲能力認證 級別：知識力級

考試地點： 考試日期：2025-02-23

報名時間：2025-02-18~2025-02-19

免試科目說明：
1.實用級免試學科：須為相關科系之碩士以上畢業者，才可點選。(須檢附畢業證明)
2.專業/專家級免試學科：須為相關科系之博士畢業者，才可點選。(須檢附畢業證明)
3.學、術科成績僅保留3年，線上申請免試科目請填選((免試科目)) 和右邊的((通過年度))，以利審核。

免試科目: 免試科目 通過年度: 通過年度

報名留言：



顯示報名成功即可，也可進入會員專區查詢

最新消息	關於協會	能力認證	技藝技職教育	培訓活動	競賽活動	人力平台	下載專區	會員專區
------	------	------	--------	------	------	------	------	------

首頁 / 能力認證梯次一覽表 / 能力認證-線上報名

能力認證報名入口



培訓活動報名

電路板設計知識力認證講師研習

活動地點：TEMI教育訓練中心
活動日期：2024-08-31~2024-08-31
報名日期：**報名截止**
» 更多活動查詢

聯絡資訊

台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
信箱：temi@temi.org.tw
電話：(02)2223-9560#505
(02)8227-5565
傳真：(02)8227-5559
地址：235新北市中和區中興路二段419號6樓之一

能力認證 線上報名

報名基本資訊 認證說明 認證流程 考場一覽 考場 Gmap

梯次編號：UK2505 備註：

職類：電子元件拆與銲能力認證 級別：知識力級

考試地點： 考試日期：2025-02-23

報名時間：2025-02-18~2025-02-19

免試科目說明：
1.實用級免試學科：須為相關科系之碩士以上畢業者，才可點選。(須檢附畢業證明)
2.專業/專家級免試學科：須為相關科系之博士畢業者，才可點選。(須檢附畢業證明)
3.學、術科成績僅保留3年，線上申請免試科目請填選((免試科目)) 和右邊的((通過年度))，以利審核。

免試科目: 免試科目 通過年度: 通過年度

報名留言：



感謝您 報名成功!!! 請到會員專區 查詢報名紀錄

四、相關資訊查詢-登入會員專區

可查詢 報名紀錄、繳費狀態、免試科目、學術科成績 及 成績狀態



TEMi 會員專區

會員專區首頁 > 能力認證報名紀錄

繳費狀態	梯次編號	職類	級別	考試時間	考試地點	免試科目/通過年度	准考证號碼	學科成績	術科成績	成績狀態	備註	報名日期
未審核	MP18119	單晶片能力認證	實用級	2018-12-22	明志科技大學	無		60	及格	通過		

5. 繳費資訊

★ 銀行匯款:

銀 行 名 稱	第一銀行 (代號 007)
分 行 名 稱	仁愛分行 (代號 1602)
戶 名	台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
帳 號	16010082093

★ ATM 匯款:

銀 行 名 稱	第一銀行 (代號 007)
帳 號	16010082093

※注意事項:

匯款完畢煩請回傳下列資訊，以利查核款項，未回傳者，該筆款項將無法查核，謝謝！

1. 回傳匯款收據或照片，亦可提供匯款日期及帳號後 5 碼
2. 參與活動或認證者的姓名
3. 活動或認證之日期、名稱、地點

【回傳方式】

1. E-MAIL: temi@temi.org.tw
2. 傳真: (02) 8227-5559